

テクノフェスタ・新春懇親会の開催について

ファインセラミックスに関する最新情報の提供、また交流の場としても恒例となりました第34回JFCAテクノフェスタ・新春懇親会を下記の通り開催致します。参加ご希望の方は、申込用紙にご記入の上、事務局宛にお申込み頂きますようお願いいたします。

記

1. 日 時 2020年1月27日(月) 10:00~18:00 (昨年度より30分早くなっております)

2. 場 所 メルパルク東京 東京都港区芝公園 2-5-20 TEL:03-3433-7211
<http://www.mielparque.jp/tokyo/access/>

3. 内 容 詳細はプログラムをご覧ください

(1) テクノフェスタ「オーラル・ポスターセッション」 10:00~14:10

各社の先端技術について、開発担当者と直接情報交換して頂く本セッションは、既存の学会や展示会では得られない情報交換の場としてご好評頂いております。また今回は招待枠として、近年注目を集めております『ファインバブルの活用』について高知工業高等専門学校 准教授 秦隆志様よりご報告頂きます。

(2) テクノフェスタ「講演会」 14:20~16:00

『温度差発電を利用したIoT センサ用自立電源』

物質・材料研究機構 エネルギー・環境材料研究拠点 熱電材料 Gr 主任研究員 高際 良樹 様

『産業分野におけるサイバーセキュリティ政策』

経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 企画官
情報処理安全確保支援士

鴨田 浩明 様

(3) 新春懇親会 16:30~18:00

JFCA テクノフェスタ終了後、同会場で開催いたしますので、引き続きご出席頂きますようご案内申し上げます。

4. お申込み・お問合せ先

(1) 参加費

テクノフェスタ・新春懇親会：JFCA 会員企業の方は無料です。

(非会員で民間企業の方の参加費は5,000円です)

(2) お申込み・お問合せ先

(一社)日本ファインセラミックス協会 岩頭 E-mail: iwagashira@jfca-net.or.jp

TEL:03-3431-8271 FAX:03-3431-8284

以 上